

Ing. Tomáš Novák

Příhláška k obhajobě disertační práce

Soupis publikací podle šablony ČSN ISO 690 + ISBN

Písemná práce ke státní doktorské zkoušce

Novák, T.: Intermetalické sloučeniny v bezolovnatém pájeném spoji, písemná práce ke státní doktorské zkoušce, ZČU Plzeň, 2011, 37 s.

Statě ve sborníku

Hujer, Tomáš: Testování pájitelnosti v inertní atmosféře. In *Elektrotechnika a informatika 2008. Část 2., Elektronika*. V Plzni: Západočeská univerzita, 2008, s. 81-84. ISBN: 978-80-7043-701-8.

Novák, Tomáš: Závislost pájitelnosti na drsnosti DPS. In *Elektrotechnika a informatika 2009. Část 2., Elektronika*. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009, s. 101-104. ISBN: 978-80-7043-809-1.

Novák, Tomáš; Steiner, František: Surface Roughness Influence on Solderability. In *International Spring Seminar on Electronics Technology*. Brno: Brno University of Technology, 2009, s. 280-281. ISBN: 978-80-214-3874-3.

Novák, Tomáš; Steiner, František: Surface Roughness Influence on Solderability. In *ISSE 2009*. Piscataway : IEEE, 2009, s. CD. ISBN: 978-1-4244-4260-7.

Novák, Tomáš; Steiner, František, Starý, Jiří; Stejskal, Petr: Solderability Dependence on Surface Roughness. In *Electronic Devices and Systems*. Brno: Brno University of Technology, 2009, s. 271-276. ISBN: 978-80-214-3874-3.

Novák, Tomáš; Steiner, František: Vliv drsnosti povrchu na pájitelnost desek plošných spojů. In *Diagnostika '09*. Srní: Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň 2009, s. 183-186. ISBN: 978-80-7043-793-3.

Novák, Tomáš; Steiner, František. The area of spread solderability test use for roughness influence assessment. In *ISSE 2010*. Warsaw: Warsaw University of Technology, 2010. ISBN: 978-83-7207-874-2.

Hujer, Tomáš; Konárek, Zdeněk; Novák, Tomáš; Steiner, František: Building of web-enable expert system for solderability testing. In *ISSE 2010*. Warsaw: Warsaw University of Technology, 2010. ISBN: 978-83-7207-874-2.

Hujer, Tomáš; Konárek, Zdeněk; Novák, Tomáš; Steiner, František.: Solderability Testing Expert System. In *EDS '10 IMAPS CS International conference proceedings*. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. s. 110-114. ISBN: 978-80-214-4138-5.

Novák, Tomáš; Steiner, František: Effect of Thermal Stress and Constitution of Lead-Free Soldering Alloys on Creation and Growth of IMC. In *EDS '10 IMAPS CS International conference proceedings*. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010, s. 229-234. ISBN: 978-80-214-4138-5.

Novák, Tomáš. Zkoumání růstu IMC v pájeném spoji. In *Elektrotechnika a informatika 2010. Část 2., Elektronika*. Plzeň: Západočeská univerzita, 2010. s. 97-100. ISBN: 978-80-7043-914-2.

Novák, Tomáš; Hujer, Tomáš; Steiner, František: Long-term behavior of IMCs in lead-free solder joints. In *ISSE 2011*. Hihg Tatras : Technical University of Košice, 2011. ISBN: 978-80-553-0646-9.

Wirt, Václav; Hujer, Tomáš; Novák, Tomáš; Rendl, Karel; Steiner, František: Comparison of solderability testing methods of PCBs with different surface finishes. In *EDS '11 IMAPS CS International conference proceedings*. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 229-234. ISBN: 978-80-214-4303-7.

Novák, Tomáš; Steiner, František: „*Influence of Intermetallic Compounds Growth on Properties of Lead-free Solder Joints*“. In 35th International Spring Seminar on Electronics Technology 2012. Bad Aussee, Austria: Vienna University of Technology, Austria, 2012. s. 213-217 E-ISBN: 978-1-4673-2239-3, DOI: 10.1109/ISSE.2012.6273075.

Novák Tomáš; Machač Jan; Steiner František: Usage of inert atmosphere for solderability testing. In *EDS '12 IMAPS CS International conference proceedings*. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 77 - 82. ISBN: 978-80-214-4539-0.

Článek

Novák, Tomáš; Steiner, František; Starý, Jiří; Stejskal, Petr: Solderability Dependence on Surface Roughness. In konference EDS 2009, Electroscop. ISBN: 1802-4564.

Novák, Tomáš; Steiner, František: Effect of Thermal Stress and Constitution of Lead-Free Soldering Alloys on Creation and Growth of IMC. In Číslo 3. 2010 - EDS 2010, Electroscop. ISBN: 1802-4564.

Funkční vzorek

Steiner, František; Novák, Tomáš: Zařízení pro zajištění inertní atmosféry při testování pájitelnosti. Západočeská univerzita, 2008.

Přednáška, poster

Novák, Tomáš: Effect of Thermal Stress and Constitution of Lead-Free Soldering Alloys on Creation and Growth of IMC - přednáška.

Novák Tomáš; Machač Jan; Steiner František: Usage of inert atmosphere for solderability testing - poster.

Wirt, Václav; Hujer, Tomáš; Novák, Tomáš; Rendl, Karel; Steiner, František: Comparison of solderability testing methods of PCBs with different surface finishes - poster.

Hujer Tomáš; Konárek Zdeněk; Novák Tomáš; Steiner František: Building of web-enabled expert system for solderability testing- poster.

Hujer Tomáš; Konárek Zdeněk; Novák Tomáš; Steiner František: Solderability testing expert system- poster.

Novák Tomáš; Steiner František: Influence of intermetallic compounds growth on properties of leadfree solder joints - poster.

Novák Tomáš: The area of spread solderability test use for roughness influence assessment - poster.

Novák, Tomáš; Steiner, František; Starý, Jiří; Stejskal, Petr: Solderability dependence on surface roughness - poster.

Novák, Tomáš; Steiner, František: Surface roughness influence on solderability - poster.

